金属材料の表面処理に関する研究(第3報)

一窒化処理品の複合分析― 小寺 将也*、大川 香織*

Study on surface treatment for metal (III) - Multiple analysis of a nitride product -KODERA Masaya*, OKAWA Kaori*

金属製品の機能向上のために使用される窒化処理は、表面を硬化させ耐摩耗性を向上させるなどの機能がある ことから広く使用されている。窒化処理を施した製品を評価するためには試料の切断などの調整をする必要があ り煩雑である。本研究では窒化処理を簡便に評価するための方法について検討し、工具等に使用される鋼材に対 して窒化処理を施し、複合的に分析を行った。

1. はじめに

金属材料を高機能化させるためには表面処理が非常に 有効であり、そのうちの一つとして窒化がある。窒化と は表面硬化熱処理の一種で、鋼等の金属製品の表面から 窒素を拡散侵入させ、製品の表面を硬化させる加工技術 である。焼入れと比較し寸法変化が少なく、耐摩耗性が 向上するため、精密部品等に利用されている。

窒化処理を適切に管理するためには窒化深さを測定す る必要があるが、測定の際は試料を切断、樹脂包埋、鏡 面研磨して硬度測定をしなければならず煩雑である。そ こで本研究では、より簡便な窒化層の評価を目指し、窒 化処理を施した試験片に対して複合的な分析を行い、適 切な評価方法について検討した。

2. 実験

既報 1) の 20mm 角×6mm の SCM440 調質材の試験片 に、480℃、6 時間の窒素拡散処理を行った。窒素拡散 処理は化合物層の形成を抑制する窒化(以下、条件1) と促進させる窒化(以下、条件2)の2種類で行った。 表面層の構造分析は X 線回折装置((株)リガク製、 SmartLab) を用い、X線源はCu、管電圧40kV、管電流 30mA で測定した。表面層の化合物層厚さの分析はグロ 一放電発光分光分析装置(GD-OES(株)堀場製作所製、 GD-PROFILER2) で、φ4 mmの領域を測定した。窒素分 布は、電子線マイクロアナライザ (EPMA 日本電子 (株) 製、JXA-8530F) を用い、試料断面の最表面から 400µm までの窒素分布状態を線分析した。残留応力は 微小部 X 線応力測定装置((株)リガク製、 AutoMATEII) を用いて測定した。測定方法は sin²ψ 法、 X線源はCrであり、管電圧40kV、管電流40mA、コリ メータ径 φ1.0 mmとした。測定の不確かさを考慮するた め、5回測定し平均値をとった。硬さ試験は、深さ0.02 ~0.36mm までをマイクロビッカース硬度計 (Struers 製、 DuraScan) を用いて HV0.05 (加重 50g) で測定した。 試験片の断面作成は、試験片を樹脂包埋した後 #2400 までの湿式研磨を行い、さらに粒径 3μm および 0.1 μm のアルミナでバフ研磨を行った。

3. 結果及び考察

試験片表面層の構造解析を行うため X 線回折装置に よる測定を行い、図1に結果を示す。未処理の試験片に は α-Fe の存在を示す回折ピークのみが検出された。条 件 1 の試験片は α -Fe に加え γ '-Fe₄N の回折ピークが見ら れた。条件2の試験片は α-Fe、 γ '-Fe₄N、さらに ε-Fe₂₋₃N の回折ピークが見られた。これらの結果より試験片表層 の化合物層の状態がそれぞれ異なることが分かった。

図2に、GD-OES 分析による窒素の深さ分析の結果を 示す。条件 1 では深さ約 2 μm、条件 2 では深さ約 3 μm の窒素が認められた。これは X 線回折測定により検出 された化合物層であると考えられる。化合物層よりもさ らに深い領域で検出されている窒素は拡散層であると思 われるが、拡散層の厚みが GD-OES の測定限界である 100µm 以上と推定され測定することはできなかった。 そこで、拡散層厚さの確認をするため、試験片断面の EPMA 分析を行った。結果を図3に示す。表層から数 ミクロンの領域に強度 7000 程度の化合物層を示すピー クが検出された。窒素拡散層の強度変化を強調するため、 縦軸の強度の範囲を 1000 から 2000 とした図を併せて示 す。図より、条件 1、条件 2 ともに拡散層厚さは約 300μm であることが分かった。

拡散層厚さと硬度の関係を確認するため、マイクロビ ッカース硬度試験機による試験片断面の硬度測定を行っ た。結果を図4に示す。未処理試験片の硬度は約 300HV であったため¹⁾、図より約 300μm まで硬度が上 昇していることが分かった。これは EPMA 測定の窒素 深さ分析で測定した拡散層の範囲と一致している。

^{*} 技術支援部

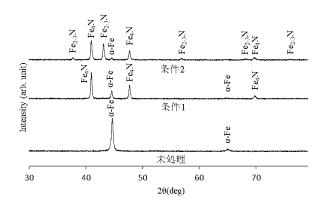


図1 X線回折装置による室化表面層の測定

窒化処理による圧縮残留応力を評価するため残留応力 測定を行った。結果を図5に示す。試料表面の研削痕に よる影響について比較するため、研削痕に対して平行方 向(//と表記)と、垂直方向(」と表記)のそれぞれに ついて測定した。図より、未処理の試験片において、」 は//と比較して圧縮残留応力の値が約2倍高かった。こ れに対し窒化処理をした試験片は、条件1、条件2とも に、」と//の測定値の差が10%未満であった。また、条件1、条件2ともに、未処理の試験片と比較して圧縮残 留応力が上昇した。

4. まとめ

- (1) X 線回折分析により窒化試験片の表面化合物層を分析し、窒化条件により化合物層の種類が異なることが分かった。
- (2) 化合物層厚さと拡散層厚さの分析について検討したところ、GD-OES 分析は試験片表面化合物層厚さ分析に適し、EPMA 分析は窒素拡散層厚さ分析に適していることが分かった。
- (3) 窒化処理により圧縮残留応力は向上し、分析試験片の表面状態と測定方向により応力の値が異なることが分かった。特に窒化未処理では試験片表面状態により応力値が約2倍異なっていた。

窒化処理を施すと窒素拡散層が形成され残留応力が生じる。このため残留応力を測定することにより窒素拡散層厚さが推定できることが示唆された。残留応力測定では試料切断などの調整の必要がないため、窒化を評価するための手順を簡略化できることが期待される。今後は残留応力測定による化合物層厚さの影響について検討していく。

【参考文献】

1) 小寺ら,岐阜県産業技術総合センター研究報告 No.1, pp27-28, 2020

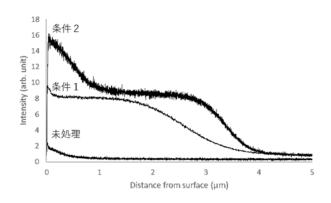


図2 GD-OES 分析による深さ方向分析

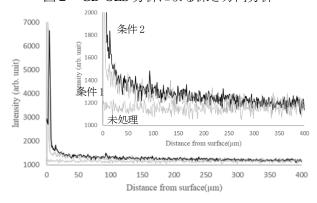


図3 EPMA 分析による深さ方向分析

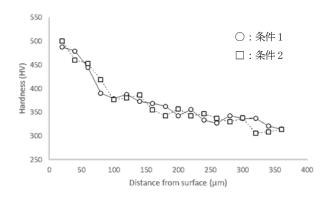


図4 マイクロビッカースによる深さ方向の硬さ測定

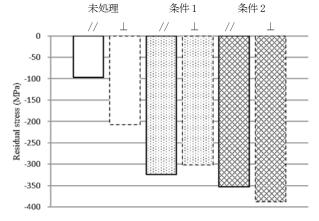


図5 残留応力測定